

CP 系列导热绝缘帽套 End Cap

产品特性 Features

- 低热阻抗与缓冲效果
Low thermal contact impedance and buffer effect
- 高绝缘性
Good electrical insulation
- 降低产品重量
Decrease the weight of the product
- 简易安装组件
Easy to assemble

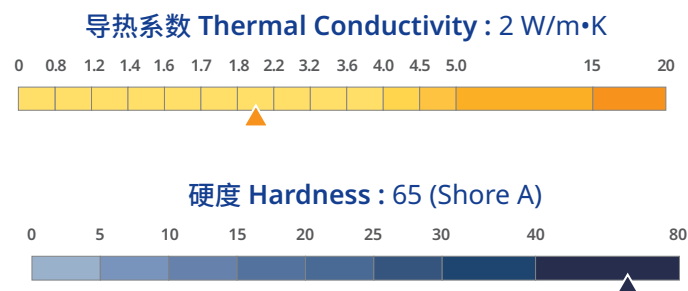
产品应用端 Application:

电子元件 Electronic Components - 5G, Aerospace, AI, AIoT, AR/VR/MR/XR, Automotive, Consumer Devices, Datacom, Electric Vehicle, Electronic Products, Energy Storage, Industrial, Lighting Equipment, Medical, Military, Netcom, Panel, Power Electronics, Robot, Servers, Smart Home, Telecom, etc.

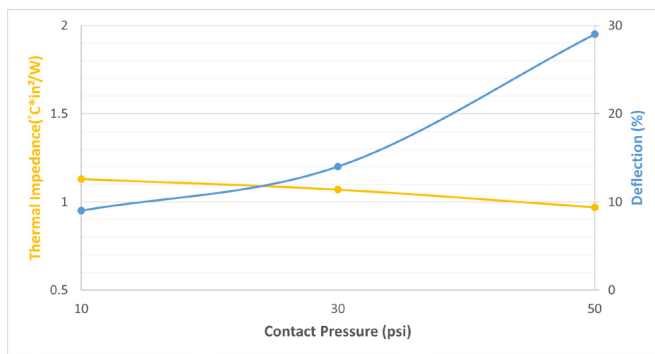
尺寸标准 Standard Sizes (mm):

1. CP22 TO-220: 11.4x16x5.8
2. CP23 TO-220: 11.4x21.5x5.8
3. CP33 TO-247: 17.5x28.5x5.8

产品物性 Properties



压力, 热阻抗, 变形量示意图 Contact Pressure, Thermal Impedance, and Deflection



Properties	Unit	CP22/CP23/CP33	Tolerance	Test Method
导热系数 Thermal Conductivity	W/m·K	2	±10%	ASTM D5470 Modified
厚度 Thickness	mm	0.3/0.45	-	ASTM D374
颜色 Color	-	灰 Gray	-	-
材料 Material	-	Silicone	-	-
工作温度 Operating Temperature	°C	-45~+180	-	-
密度 Density	g/cm³	2.55	±5%	ASTM D792
交流耐电压 Dielectric Breakdown Voltage (AC)	KV	≥4.1/≥6.1	-	ASTM D149
直流耐电压 Dielectric Breakdown Voltage (DC)	KV	≥6.1/≥8.1	-	ASTM D149
介电系数 Dielectric Constant	1000Hz	5.8	-	ASTM D150
热阻抗 Thermal Impedance@10psi	°C*in² / W	1.13	-	ASTM D5470 Modified
热阻抗 Thermal Impedance@20psi	°C*in² / W	1.07	-	ASTM D5470 Modified
热阻抗 Thermal Impedance@50psi	°C*in² / W	0.97	-	ASTM D5470 Modified
硬度 Hardness	Shore A	65	±7	ASTM D2240

高柏科技 T-Global Technonology Co., Ltd.

桃园市桃园区大仁路 50 巷 33 号 No.33, Ln.50, Daren Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330058, Taiwan
 T +886-3-361-8899 E service@tglobalcorp.com W www.tglobalcorp.com

Version19
20240220



注意：本技术数据表内的资讯是根据高柏团队的研究与测试得出的最佳数据。本技术数据表中列出的值仅代表典型值，并非对每一批生产的物料都进行测试。所有规格如有变更，恕不另行通知；无影响产品功能之保护膜及离型纸，如非特殊要求，皆依高柏默认为准。由于各种可能的使用条件超出了我们的控制范围，因此我们提出的所有建议均不构成保证或责任，用户应自行进行测试，以确定我们的产品在任何特定情况下的适用性。本产品的销售没有任何明示或暗示的说明，表示其适用于特定目的或其他用途的保证，但本产品应依据高柏与您确认的发票、报价、或订单，提供最标准的产品质量。我们不承担使用者如何延伸或改变此技术数据表中的资讯，使用者应承担所有风险。此外，本技术数据表中的资讯不包含任何内容解释与涉及产品材料的现有用途、未来专利冲突、工艺制造，与使用产品的建议。